

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

## 湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260625

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称 及人员姓名	2026年6月24日下午15:00~17:00：融通基金：刘安坤、苏林洁、刘申奥、王迪、关山、杨冷枫、钱佳兴，太平养老：李宏、黄强、陆坚、张凯、陈宁玉、吴涛、黄浩、刘俊、韩成、王书伟，上海承风金萍私募基金：余承、李蓬勃，上海九方云智能科技司：王德慧，浙江圣熙资产：王峰，汉景资本：代勇峰，国元证券：李靖，太和投资：李轩，齐润投资：禹玉宏，钵钵投资：蔡学标、王莹，上海仙人掌私募基金：刘日光，东北证券：高蕾、金琼璟、孙郁柳，上海迈朵：董志文，淳阳基金：刘晓薇，群英汇力阳光私募：张自忠，江南基金：李展发，杭州尚泽：钟昶，千马会：唐池，深圳市前海远方投资：彭静，原科恒辉：迟永年，招商证券：廖世刚，LLU 俱乐部：谢文豪，中航证券：邓轲，湖北夷陵经发控股集团：李治敏，共43名投资者及证券人员 2026年6月25日上午9:00~10:00：泰康资产：鲍亮、王晓锋、张永兴、袁哲航，泰康基金：卞学清，共5名投资者及证券人员
时间	2026年6月24日下午15:00~17:00，2026年6月25日上午9:00~10:00
地点	公司9楼会议室
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书杨平彩女士
投资者 关系活动 主要内容 介绍	<b>公司介绍：</b> 公司是国内领先的关键大赛道领域中各类核心创新材料的平台型公司，主营业务横跨两大板块—半导体业务板块、锂电业务板块。现阶段，公司重点聚焦半导体创新材料业务，业务覆盖：半导体制造用CMP工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块，是集成电路用CMP抛光垫国内供应龙头，占据OLED新型显示材料YPI、PSPI国内供应领先地位，深度布局半导体KrF/ArF晶圆光刻胶、半导体先进封装材料等业务，新近切入新能源锂电关键功能材料领域，推动公司高速可持续发展。

**问 1：公司近期公告 KrF/ArF 高端光刻胶新增近千加仑批量订单，请介绍本次订单突破背后的核心竞争力，以及 2026 全年光刻胶商业化放量规划？**

**答：**本次新增近 1000 加仑浸没式 ArF、KrF 光刻胶订单，是潜江年产 300 吨高端光刻胶全流程产线 3 月 20 日投产后，下游头部客户对公司产品性能、交付稳定性的直接认可。核心差异化优势分为三层：第一，产线为国内首条覆盖有机合成、高分子聚合、高纯精制、光刻胶混配全自主制备量产线，光刻胶主体树脂、光酸、高纯单体核心原料自研自产，从源头规避海外供应链断供风险，纯度、金属离子管控指标对标国际一线厂商；第二，产品矩阵覆盖全面，目前累计布局 40 余款高端晶圆光刻胶，近 30 款送样验证，8 款 ArF/KrF 产品已获批量订单，较一季度新增 5 款型号，同步配套 BARC、SOC 等光刻辅材，可为客户提供一体化光刻耗材解决方案；第三，验证与交付体系成熟，产线柔性自动化设计，可快速匹配不同客户多种类产线需求，现有头部客户已将我司产品导入量产线稳定使用，反馈良率、工艺适配性表现优异。

全年放量层面，上半年产品交付规模将实现显著同比提升；下半年将持续推进剩余多款在测型号的加仑样验证与订单转化，同步根据客户长期需求优化产能排产节奏，持续提升国内高端光刻胶产业化进程。

**问 2：铜阻挡层抛光液、SiC 碳化硅衬底抛光液均落地批量订单，同时斩获头部晶圆厂优秀供应商奖项，请问抛光液业务增长的核心原因，以及与抛光垫业务的协同效应？**

**答：**公司抛光液业务能够持续实现产品批量落地、营收稳步增长，得益于产品技术持续迭代，多品类工艺性能匹配量产标准。针对成熟制程铜阻挡层抛光液，在颗粒稳定性、整体抛光速率等关键指标上已满足产线量产要求，能够适配国内多条产线配套需求；面向第三代半导体赛道研发的 SiC 衬底抛光液，可匹配碳化硅衬底高精度镜面加工需求，两大核心品类先后完成验证并收获批量订单，直接打开业务收入增长空间；氧化硅、硅基抛光液及配套清洗液同步推进下游导入，形成多产品同步贡献收入的格局。同时下游应用赛道需求持续扩容，国产化配套需求持续释放。一方面国内晶圆制造厂商持续建设投产，铜制程 CMP 抛光液市场配套规模稳步提升；另一方面碳化硅衬底加工耗材具备广阔市场发展空间，两大高景气赛道为抛光液业务提供长期需求支撑。

垫液协同是公司独有核心优势，公司可向国内头部厂商提供“抛光垫 + 抛光液 + 清洗液”成套工艺耗材，客户可统一对单一供应商完成工艺适配、联合调试、售后技术服务，大幅提高客户验证效率；同时内部研发端依托公司七大核心技术平台的长期积淀，新品开发周期大幅缩短，形成客户粘性与技术双重壁垒。2026 年抛光液业务收入增速预计保持良好态势，成为 CMP 板块重要增量。

**问 3：公司潜江 300 吨光刻胶产线实现核心树脂、光酸自主配套，上游原材料自主化对产业化带来哪些优势？**

**答：**高端光刻胶核心树脂、高纯光酸是行业关键上游材料，公司实现全

链条自研自产，可从产品矩阵、客户合作等多维度构建长期支撑。

全流程一体化量产产线优势：公司建成从树脂合成到光刻胶混配的完整自主量产体系，全流程工艺经过批量供货验证，在产品纯度、批次一致性、工艺快速迭代方面具备成熟积累，能够稳定满足制造端量产严苛标准；完善的全系列产品矩阵优势：公司同步研发四十余款光刻胶产品，覆盖不同制程和不同使用场景的各类工艺节点，叠加配套光刻辅材一体化供给，可满足下游客户多元化配套需求；深度长期客户合作优势：多家头部晶圆制造企业已完成公司产品批量导入，并建立常态化联合产品开发机制，合作粘性较强；上游核心原材料自研自产优势：树脂、光酸自主生产带来供应链稳定、成本优化、工艺定制三重综合价值，是公司长期经营形成的特色壁垒。

后续公司将持续提速新品下游验证与订单转化节奏，依托一体化成套耗材方案、稳定批量交付能力持续扩大国产化配套规模，巩固国产高端光刻胶核心配套企业地位。

**问 4：公司同步布局晶圆光刻胶、先进封装材料多条电子材料赛道，平台化多品类布局具备哪些差异化核心优势，跨品类客户协同转化落地效果如何？**

**答：**全平台多材料协同布局是公司长期发展形成的核心特色优势，价值集中体现在资源复用、底层研发共享、跨品类订单转化三个维度。

第一，客户资源高度互通：高端晶圆光刻胶、CMP 系列材料服务晶圆制造客户，柔性显示材料对接面板制造企业，先进封装材料面向封测厂商，同一客户可同步采购公司多系列耗材，持续提升单客户配套体量；例如多家晶圆制造客户同步采购抛光垫、抛光液、高端晶圆光刻胶及配套湿化学品，一站式配套能够提升客户供应链管理效率。

第二，底层技术可跨赛道复用：高分子合成、高纯化、精密涂布等为各业务通用核心技术，研发设备、高端检测平台、专业技术人才可跨板块共享研发资源，新品开发效率优势突出；如光刻胶树脂合成技术可直接迁移应用于 PSPI 聚酰亚胺、封装材料的研发迭代。

第三，跨品类订单转化成效持续显现：多家客户在导入 CMP 系列耗材后，同时启动高端晶圆光刻胶验证工作；可依托成熟合作基础有效缩短新品验证周期。未来多品类协同配套作用将逐渐体现，平台化经营红利持续释放。

**问 5：公司集中资源倾斜半导体核心材料赛道，请介绍业务结构优化最新进展，以及资源集中投放后半导体板块研发、产能建设落地规划？**

**答：**为聚焦高成长半导体创新材料核心赛道，公司稳步推进传统打印耗材业务资产优化处置，相关处置回笼资金将全部用于半导体材料研发投入与产能扩建。

2026 年伴随光刻胶、抛光液、先进封装材料持续放量，半导体业务营收及盈利贡献占比将进一步提升。资源倾斜落地规划分为两大方向，一是研发端，公司维持高强度年度研发投入，持续扩充研发场地、新增高端精密检测设备，扩大光刻材料、CMP 耗材、第三代半导体材料专业研发团队，重点攻坚高端晶圆光刻胶、配套辅材、全系列抛光耗材、先进封装专用材料等前沿产品；二是产能端，稳步推进 CMP 抛光垫软垫产能扩建，同步规划第

	<p>三代半导体、先进封装材料专用产线，匹配国内产业配套的长期需求。业务优化完成后，公司现金流、资产结构持续改善，资本开支可集中投向高景气半导体材料赛道，进一步夯实中长期发展确定性。</p> <p><b>问 6: 公司推进 H 股上市筹备工作, 请介绍相关发展规划与推进节奏?</b></p> <p><b>答:</b> 公司筹划 H 股发行上市, 核心服务于全球化产业布局、海外市场拓展、中长期资本储备三大战略目标。公司是国内领先的关键大赛道领域中各类核心创新材料的平台型公司, 目前已有多系列创新材料产品深度渗透国内市场并规模销售, 是国内集成电路制造用 CMP 抛光垫产品供应龙头, 同时布局 CMP 抛光液、清洗液等集成电路关键材料并实现市场销售; 在柔性显示材料 YPI、PSPI 领域占据国内供应领先地位, 深度布局半导体 KrF/ArF 晶圆光刻胶和先进封装材料业务, 海外市场拓展为公司中长期核心发展方向。本次筹划 H 股并于香港联交所主板上市, 核心目的为深化创新材料全球化布局, 加速海外客户开发、海外产能与研发投资落地, 全面提升公司国际品牌影响力与全球市场综合竞争力。同时, 通过搭建 A+H 双融资平台, 拓宽国际化融资渠道, 增强境外资本运作能力, 为公司半导体材料、显示材料等产品的海外研发、产线建设、海外市场并购及产业链布局提供长期资金支撑, 助力公司打造具备全球竞争力的创新材料龙头企业。</p> <p>现阶段各项筹备工作有序推进, 公司将严格按照深交所、香港联交所相关规则, 根据项目推进节点及时履行信息披露义务。</p>
附件清单	无
日期	2026 年 6 月 25 日